

事業戦略ビジョン

実施プロジェクト名 : 次世代デジタルインフラの構築プロジェクト
【研究開発項目3】次世代グリーンデータセンター技術開発、
研究開発内容① 光エレクトロニクス技術の開発／光電融合デバイス開発

実施者名 : アイオーコア株式会社 代表名：代表取締役社長 福田 秀敬

共同実施者 : 富士通株式会社（幹事会社）
日本電気株式会社
キオクシア株式会社
富士通オプティカルコンポーネンツ株式会社
京セラ株式会社

目次

1. 事業戦略・事業計画

- (1) 産業構造変化に対する認識
- (2) 市場のセグメント・ターゲット
- (3) 提供価値・ビジネスモデル
- (4) 経営資源・ポジショニング
- (5) 事業計画の全体像
- (6) 研究開発・設備投資・マーケティング計画
- (7) 資金計画

2. 研究開発計画

2.1 共同実施による研究開発内容

- (1) 研究開発目標
- (2) 研究開発内容
- (3) 実施スケジュール
- (4) 研究開発体制
- (5) 技術的優位性

2.2 光電融合デバイス開発

- (1) 研究開発目標
- (2) 研究開発内容
- (3) 実施スケジュール
- (4) 研究開発体制
- (5) 技術的優位性

3. イノベーション推進体制（経営のコミットメントを示すマネジメントシート）

- (1) 組織内の事業推進体制
- (2) マネジメントチェック項目① 経営者等の事業への関与
- (3) マネジメントチェック項目② 経営戦略における事業の位置づけ
- (4) マネジメントチェック項目③ 事業推進体制の確保

4. その他

- (1) 想定されるリスク要因と対処方針

1. 事業戦略・事業計画

1. 事業戦略・事業計画／（1）産業構造変化に対する認識

社会の情報化の進展によりデータ量が急増し、データセンタの消費電力が急拡大すると予想

カーボンニュートラルを踏まえたマクロトレンド認識

（社会面）

- 情報の利活用、デジタル化が急速に進展
- 世界のデータ量は年間約 30%のペースで急増

（経済面）

- データを処理するデータセンターサーバの市場規模は拡大の一途であり、2019 年は 6 兆円、2030 年には 25 兆円
- 今後、大規模データセンターの急増により、データセンター全体の電力消費量も大きく増加

（政策面）

- 2020年10月、日本は、「2050年カーボンニュートラル」を宣言

（技術面）

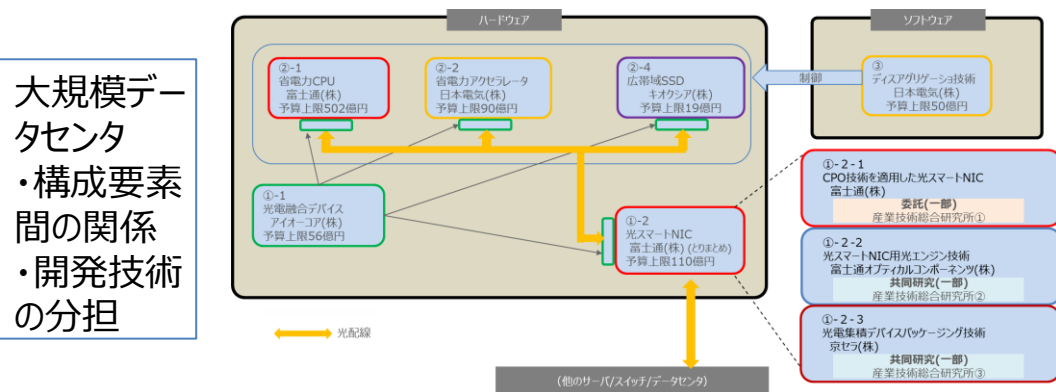
- 革新的省エネ技術である「光電融合技術」がゲームチェンジ技術として登場
- サーバを CPU やメモリ等の機能単位で分割し、計算負荷に最適配置することで、システム全体を高効率化する、ディスクアグリゲーション技術の検討が進められている。

- 市場機会： CPU等は現在、電気で配線されている。光配線を実現する上で必要なデバイス直近に配置できる光モジュールはサイズ、高温耐性の問題から存在していない。
- 社会・顧客・国民等に与えるインパクト： データの急増によるデータセンタの消費電力の課題が解決できる

カーボンニュートラル社会における産業アーキテクチャ

目的： データセンターの省エネ化、および、データセンターサーバ市場への参入・シェアの拡大を実現すること

- ✓ 大規模データセンターの省エネ化に向け「光電融合技術」と「ディスクアグリゲーション技術」を導入し、データセンターの40%省エネ
- ✓ アイオーコア(株)は、「光電融合技術」による小型光モジュールを開発し、データセンタ内の電気配線を光配線に置き換えることで省エネ化、および、データセンターサーバ市場への参入を図る



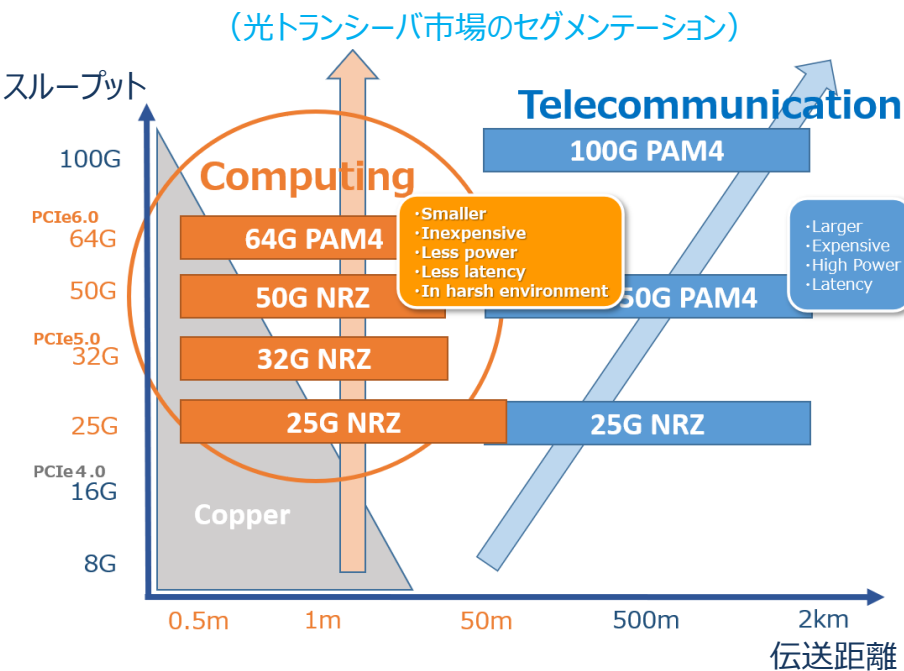
- 当該変化に対する経営ビジョン： アイオーコア(株)が開発する光モジュールは、世界最小、100℃で動作可能という特徴からサーバ内の光配線に適用可能であり、データセンターサーバの省エネ化、および、新たな市場を開くことができる。

1. 事業戦略・事業計画／（2）市場のセグメント・ターゲット

コンピューティング市場においてサーバー間／LSI間など短距離インターフェイスターゲットとして想定

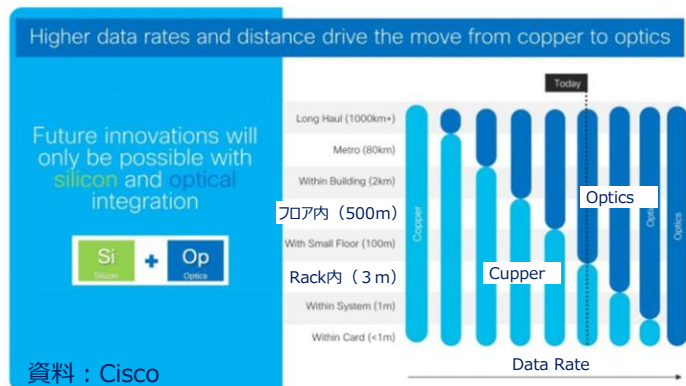
セグメント分析

- コンピューティング能力向上にあくなく渴望感
 - HPC、AI、Edge Computing、自動運転など
- コンピューティング能力の向上には並列処理・分散処理が必須だが、半導体間的高速通信がボトルネック
- 銅配線から光配線の転換の幕開け
 - 2019年 PCIe5.0が策定され32Gbps NRZを採用
 - 次のPCIe6.0は64Gbps PAM4

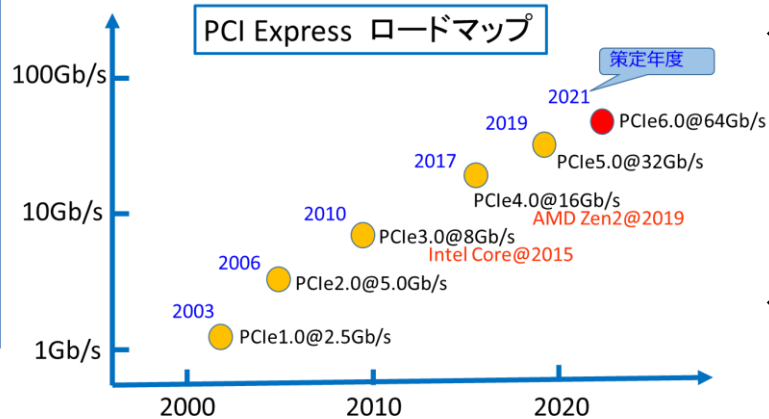


ターゲットの概要

自動運転、産業機械なども、光配線が必要となり、特に遅延（レイテンシー）の低減が不可欠
→ Edge Computing、半導体製造装置、医療機器などで光配線化が進展
→ 産業用途では屋外使用下で高い信頼性（メンテナンスフリー）が求められる



- ◆ データセンター内の光化はTop of Rack (ToR) まで進展（大規模データセンター）
- ◆ 今後、ToR内（サーバラック内）に光化が進展
- ◆ LSI近傍での高温耐性が重要
- ◆ アイオーコア社が狙うマーケットは、ToR内、即ち、コンピューティングの光化



- ◆ 2019年にPCIe5.0（32Gbps）が策定
- ◆ PCIe5.0市場は2022年から急速に拡大
 - クラウド／IT：GAFA、IBM、Microsoft、Cisco、Intel、AMD、NVIDIA、富士通、日立 など
 - 産業応用：Olympus & Sony、FANUC、Ricoh など
- ◆ OIF（光技術の標準化団体）ではコンピューティングの光技術導入についてロードマップを提示

1. 事業戦略・事業計画／（3）提供価値・ビジネスモデル

光電融合技術を用いてコンピューティング能力を飛躍的に向上させる

社会・顧客に対する提供価値

既に、国内外の大手半導体メーカ、データセンター事業者、産業機械メーカ等より、32GbpsNRZ、64Gbps PAM4へのニーズが寄せられている

技術的背景としては、半導体微細化の限界、多様な半導体の相互高速接続によるコンピューティング能力の向上への要求がある

データセンター向け

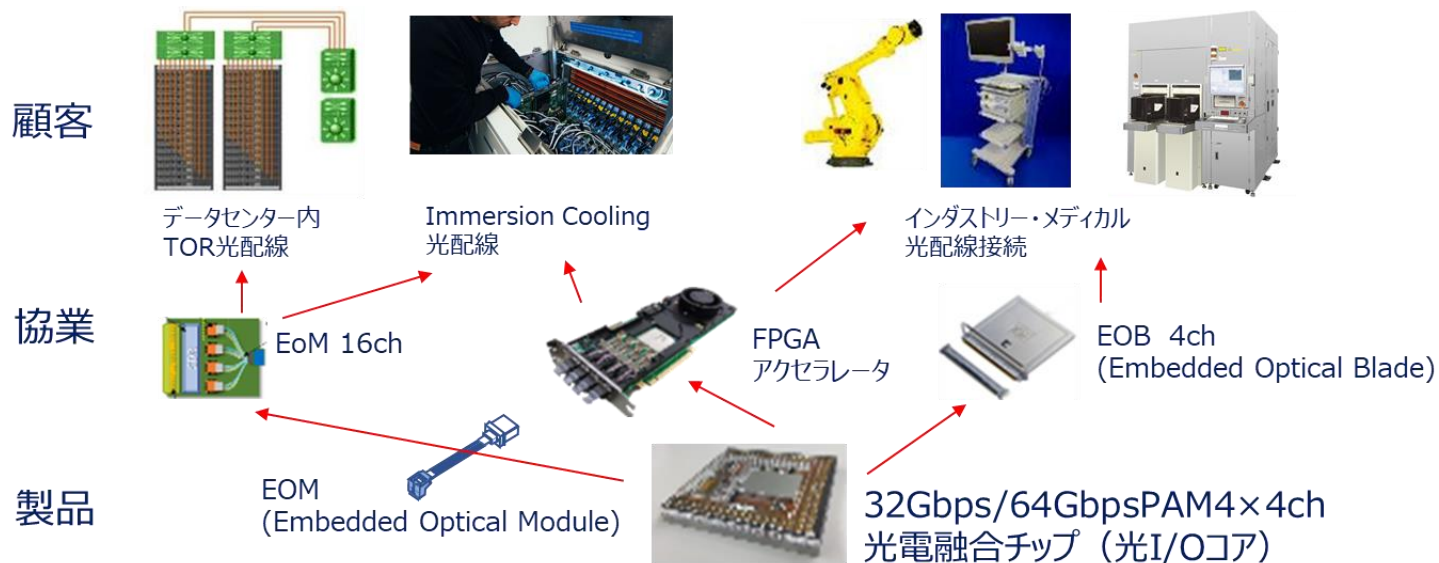
- 高温動作（Case温度で100℃近い）高信頼性の確保
- Plug-able、Socket-ableの構造等
- 距離は10m程度（銅線は1m以下）
- Interoperableでなくとも良い
- 液浸(Immersion Cooling)で使えれば更に良い など

産業機械等向け

- 高温動作、高信頼性の確保
- 薄型など形状の要求
- 液浸で使えれば更に良い など

1. 付加価値を創出するデマンド・チェーンの構築

- ✓ データセンタを始めとする顧客に対し、協業企業と連携を図り提案、開発を実施
- ✓ 協業企業とは量産に向けた将来計画も共有



2. 付加価値の源泉

- ✓ 光電融合技術により、CPU、FPGA、ASIC、メモリー等の基幹半導体を高速に接続し、コンピューティングの能力を飛躍的に向上させる
- ✓ 従来の銅配線を光配線に置き換えることにより、90%以上の省エネルギー化を図る
- ✓ 光配線により、遅延の極小化、ノイズ耐性の強化を図る
- ✓ 光電融合チップを基幹部品（弊社が担当）とし、トランシーバ段階（協業企業が担当）で用途により適切にカスタマイズを行う。

1. 事業戦略・事業計画／（4）経営資源・ポジショニング

光電融合の強みを活かして、社会・顧客に対して高速、省エネという価値を提供

ターゲットに対する提供価値

- 高温動作し信頼性の高い光電融合技術の提供
Near-Packaged Opticsの実現
- 標準化された電気接続、Socket-able、Plug-ableな光トランシーバとしての製品提供
- 銅線に比較し、省エネ、低遅延、長い距離の伝送が可能

自社の強み

- 光電融合技術を構成する量子ドットレーザー、シリフォト、IC及び実装技術に精通し、求められる製品技術の実現に最も近い
- 複数の協業企業との連携を構築済みであり、光トランシーバとしての製品提供が可能
- サプライチェーンを構築済みであり、設計から製造までトータルで開発・品質管理が可能

自社の弱み

- 先端顧客及び競合技術は海外となるため情報アクセスに米国競合企業に劣後する場合がある

対応

- 米欧の大手企業とは定期的にWebミーティングを実施
- 海外に経験あるコンサルタントを配置、海外企業のニーズを細かく把握

他社に対する比較優位性

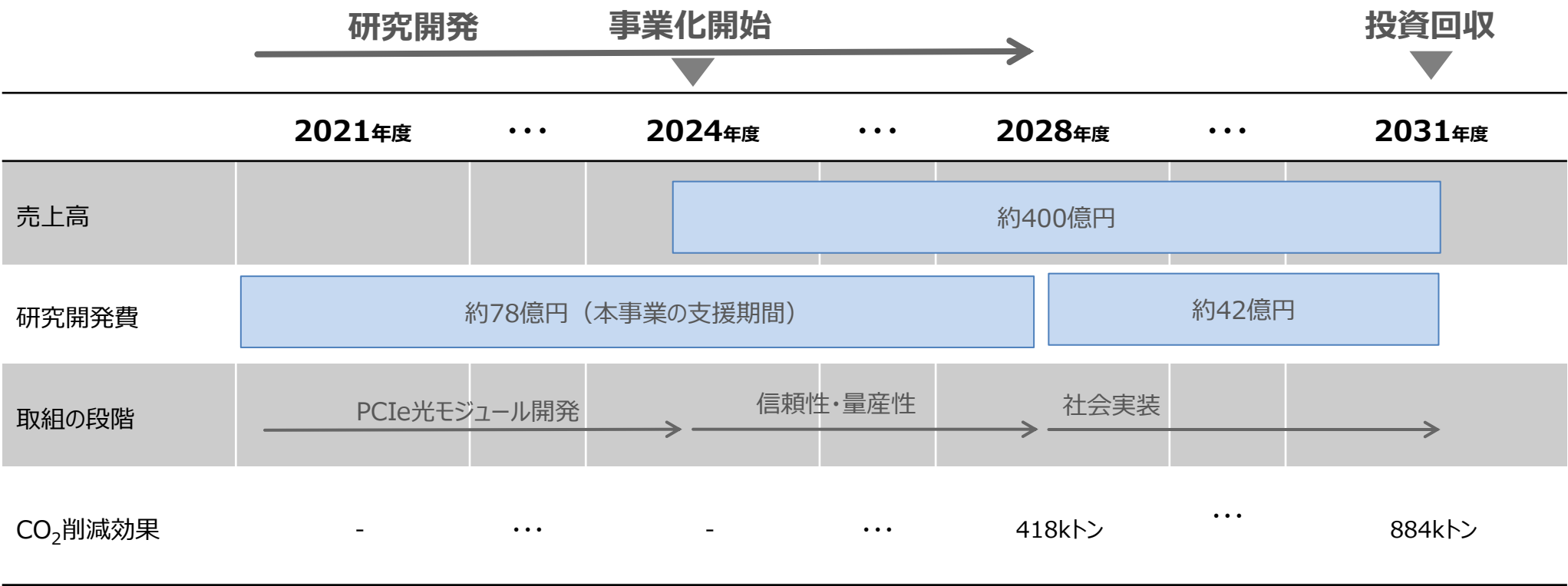
	技術	顧客基盤	サプライチェーン	その他経営資源
自社	（現在） - 高温動作を実現（～105℃）米国大手企業からの要求はNear-Packaged Opticsで～100℃ - LD、シリフォト、実装等技術蓄積あり	- 米欧の大手企業と技術、製品開発など対話を推進中 - 国内企業とも議論を開始	- 国内に試作及び製造ラインを確保済 - 中核となる製造装置は内製化を進め、コスト削減、技術漏洩を防止 - トランシーバについては国内大手企業との協業を推進	- 国内大手企業、VC資金に加え、プロジェクト費で十分な資金を確保 - 経験ある技術人材を確保 - 米欧に経験あるコンサルタントを配置 - 国内協業大手企業の海外ネットワークも活用
	（将来） - 更に高温での動作を追求（～125℃） - 更に高速化112GbpsPAM4を実現			
競合A社	- 高温動作を実現できていない（～85℃） - LD、シリフォトは高出力を追求しており、多くは外部LDを採用 - 狙いは基幹Switch向けであり、Serverには不向き	米欧の大手企業と連携	- 従来から組立ては中国企業に依存 - 本件は、高い実装技術を求められること、経済安全保障の観点からサプライチェーンの組換えが必要	- 大手企業内で資金を手当て - 経験ある技術人材を確保

1. 事業戦略・事業計画／（5）事業計画の全体像

研究開発4年目の2024年以降、研究開発成果を順次切出し事業化、2031年頃の投資回収を想定

投資計画

- ✓ 本事業終了後も2029年度以降継続的な設備投資が必要
- ✓ データセンタ市場での販売を図り、2031年度に本プロジェクト研究開発費の回収予定



1. 事業戦略・事業計画／（6）研究開発・設備投資・マーケティング計画

研究開発段階から将来の社会実装（設備投資・マーケティング）を見据えた計画を推進

研究開発段階からユーザーのニーズ（高温動作、低消費電力、低レイテンシなど）を把握し、適正な設備投資を進め、タイムリーな製品提供を図る。

研究開発・実証

設備投資

マーケティング

取組方針

- 研究開発組合PETRAでのNEDOプロジェクトの成果が基盤
- 高温動作可能なQDレーザとICをオンチップに搭載し、光ピン構造を導入することで超小型3次元実装を実現
- 光トランシーバの外観、性能、製造方法等を知財化し、インターフェース部を標準化（オープン戦略）
- クローズ戦略として、実装方法、装置仕様等をブラックボックス化し、誰も容易にまねできない体制を築く

- 光I/Oコア実装設備をEMS等に持ち込み、実装技術を移転する。EMS等に製品売上規模に応じた適正な設備投資を行う
- シリフォットのファンダリ企業に重要設備装置（GeIピ装置）を持ち込み、装置の共同活用を通じて、シリフォットファブとの連携強化
- 高温化の肝となるレーザに関して2社購買を通じてコストダウン及び安定供給を図る

- グローバルユーザーとの対話を通じて的確にニーズを把握
- システムへの導入時期を探り、適正規模の設備投資を行い、適正コストでの販売を継続

国際競争上の優位性

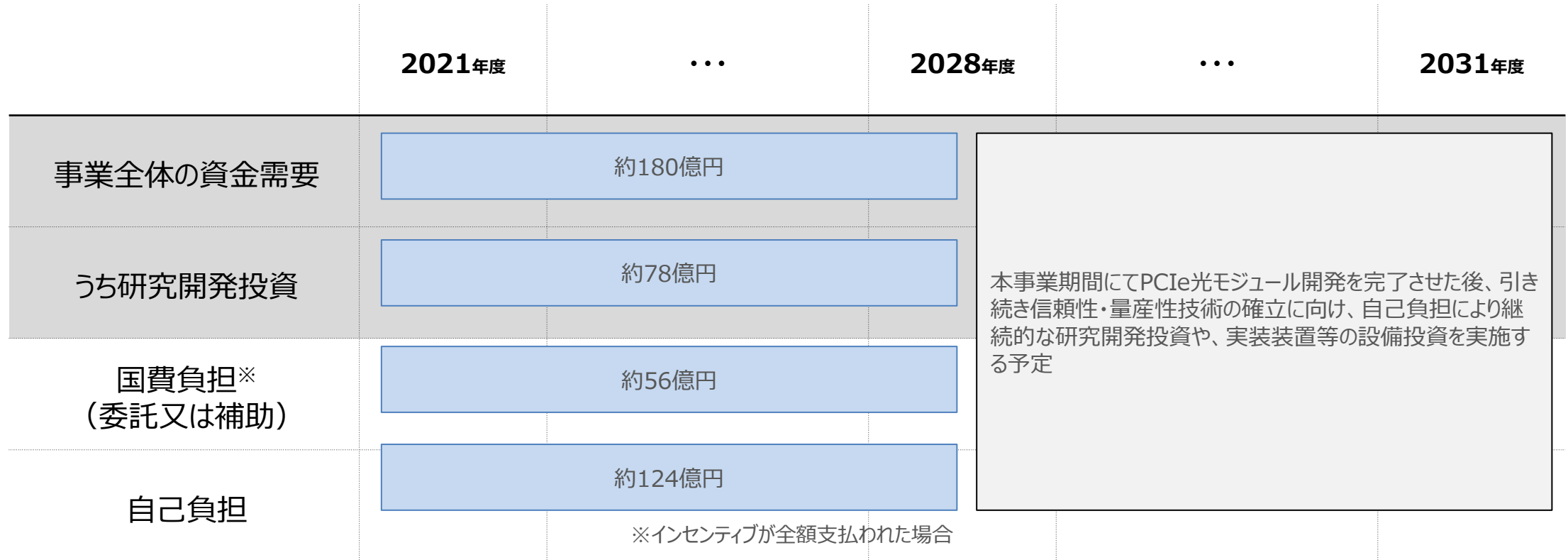
- 100℃以上の高温高信頼で動作する光トランシーバはアイオーコア社の光I/Oコアだけ
- 5mm□の3次元モジュールは世界最小クラス
- 製造装置のオペレーショナルゴリズムなどブラックボックス化し、競合との優位性を維持
- 部品（光コネクタなど）点数の削減により、コストダウンへとつなげる

- 実装ラインにはアイオーコア社オリジナルの装置を導入し、歩留りを向上。他社の模倣を防ぐとともに製品コストの低価格化を図る
- シリフォットファンダリとの連携を図り、導波路、受光器などの性能向上を進め、他社との差別化を図る
- 量子ドットレーザの製造企業との連携を進め、レーザの高性能化を図る

- ユーザーのニーズ（高温動作、高信頼、低消費電力、低レイテンシなど）に応えるタイムリーな製品提供により、他社との差別化を図る

1. 事業戦略・事業計画／（7）資金計画

国の支援に加えて、124億円規模の自己負担を予定



2. 研究開発計画

2.1 共同実施による研究開発内容

2.1 共同実施による研究開発内容／（１）研究開発目標

DCの省力化40%以上というアウトプット目標を達成するために必要な複数のKPIを設定

研究開発項目	アウトプット目標	
【研究開発項目3】 次世代グリーンデータセンター技術開発	2030 年までに、研究開発開始時点で普及しているデータセンターと比較して 40%以上の省エネ化を実現	
研究開発内容	KPI	KPI設定の考え方
① -1 光電融合デバイス開発	・PCIe6.0 に対応した光トランシーバを開発 ・チップ間接続の消費電力を電気配線と比較して 90%削減	DCの4.4%の電力消費が電気配線であり、光配線化することで配線に関わる電力を1/10までに削減する
① -2 光スマートNIC開発	・ビットあたり消費電力を従来比で1/10へ削減	現行の光伝送装置の消費電力から、CPO技術適用とレイヤ1ソフトウェア処理技術適用によりビット当たりの消費電力1/10を実現する
② -1 省電力CPU開発	・現行自社CPUに対し10倍の電力効率向上	DCの省力化40%以上を達成するためには、消費電力占有率が最も高いCPUの電力効率を10倍に改善する高い目標設定が必要
② -2 省電力アクセラレータ開発	・現行汎用CPU比10倍の電力効率、メモリ帯域 5TB/s以上	アクセラレータで利用するアプリで現行汎用CPU比10倍の電力効率。複数チップレット（複数HBM搭載）の構成で5TB/s以上のメモリ帯域を実現する
② -4 広帯域 SSD 開発	・連続リード性能(或いは帯域)を現行(PCIe® Gen.3 世代相当)から8倍にする	サーバーの電力効率を向上させるためにはストレージの広帯域化が必要。2028年にストレージシステムとして128GB/sを達成する
③ ディスクアグリーゲーション技術の開発	・制御対象機器の利用効率の最適化により、制御対象機器を制御しない場合と比較して消費電力 20%の削減	ワークロード特性に対応した動的構成変更により、最適なりソースを割り当て、不要部分の電力を削減することで消費電力を20%程度改善

※PCIe は、PCI-SIG の登録商標です。

2.1 共同実施による研究開発内容／（２）研究開発内容

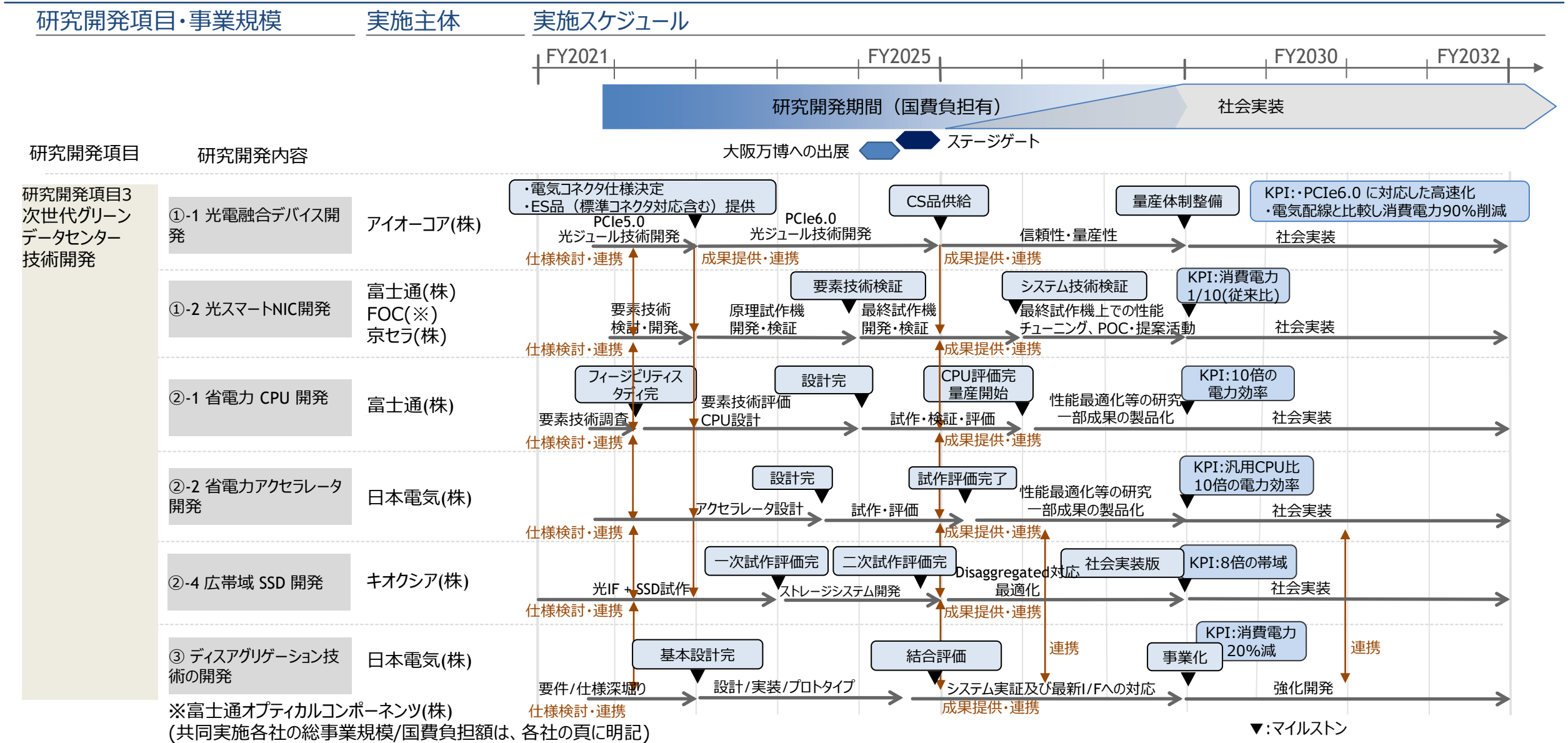
各KPIの目標達成に必要な解決方法を提案

	KPI	現状	達成レベル	解決方法	実現可能性 (成功確率)
1 -1 光電融合デバイス開発	・PCIe6.0 に対応 ・電気配線と比較して電力 90%減	電子回路等の要素技術(TRL4)	信頼性・量産性を満足した製品レベル(TRL9)	● 低損失シリコンフォトニクス回路技術 ① リニアリティの高い光素子による高速PCIe6.0 (32GBau, PAM4) ② 電子回路のCDRが不要となり低電力化	低損失シリコンフォトニクス回路の適用により高い実現可能性 (90%)
1 -2 光スマートNIC開発	ビットあたり消費電力を従来比で1/10へ削減	レイヤ1ソフトウェア処理技術は研究開発段階(TRL2)	製品一步手前のプロトタイプ機の完成(TRL6)	● システム、部品、集積の3要素技術を集結 - システム：CPO適用技術、レイヤ1ソフトウェア処理技術 - 部品：高変調効率光エンジン技術 - 集積：光電集積デバイスパッケージング技術	世界最高水準の技術を持つ3社の集結で成功確率は高い (80%)
2 -1 省電力 CPU 開発	現行自社CPUに対し10倍の電力効率向上	一部の技術開発項目において、原理確認段階(TRL1)	技術開発の検証・評価と、後半の実証システムに向けた試作(TRL4)	● 富岳で採用した省電力回路設計技術を進化 ● 省電力につながる新しいデバイスの取り込みや、テクノロジーを開発	原理確認段階の開発項目がある為 (60%)
2 -2 省電力アクセラレータ開発	現行汎用CPU比10倍の電力効率、メモリ帯域5TB/s以上	汎用CPU比5倍の電力効率、メモリ帯 1.5TB/s (TRL4)	汎用CPU比10倍以上の電力効率、メモリ帯域 5TB/s以上 (TRL5)	● ベクトル・アーキテクチャの機能強化やチップ内部のマイクロ・アーキテクチャ改良による電力効率向上 ● チップレット設計によるメモリ帯域5TB/s 構成の実現	所望アプリのベンチマーク電力当たり性能改善 (70%)
2 -4 広帯域 SSD 開発	連続リード性能(或いは帯域)を現行(PCIe® Gen.3世代相当)から8倍にする	PCIe® Gen3 相当(TRL3)	PCIe® Gen6 相当(TRL7)	● 光インターフェイスブリッジの最適実装、ディスクアグリゲーション対応ストレージ管理SW開発 - 方式① 最適帯域となる管理SW - 方式② 低電力CPUで管理SW実行	達成レベルに未達の可能性あり (70%)
3 ディスクアグリゲーション技術の開発	効率の最適化により、制御対象機器を制御しない場合と比較して消費電力20%の削減	マシン単位の構成制御・自動構成方式検討 (TRL3)	コンポーネント単位のAP要求性能に応じた動的自動構成変更 (TRL7)	● 動的構成変更技術の研究・開発 - 方式① インフラ動的構成変更 - 方式② AP実行制御	自動設計・構成技術を拡張 (70%)

※PCIe は、PCI-SIG の登録商標です。

2.1 共同実施による研究開発内容／（3）実施スケジュール

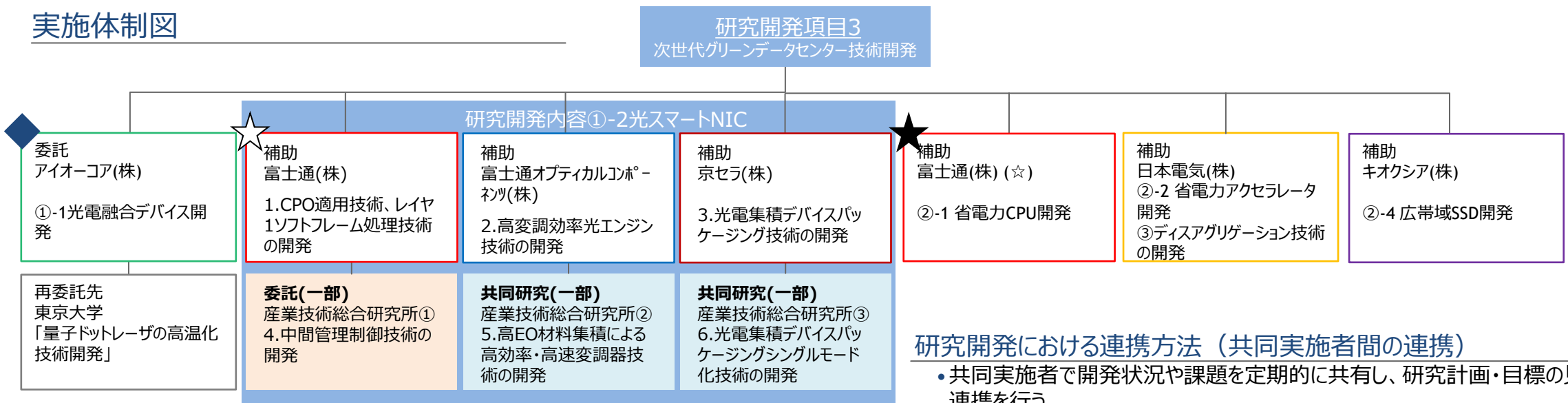
複数の研究開発を効率的に連携させるためのスケジュールを計画



2.1 共同実施による研究開発内容／（４）研究開発体制

各主体の特長を生かせる研究開発実施体制と役割分担を構築

実施体制図



(共同実施各社の総事業費/国費負担額は、各社の頁に明記)

- ★ 研究開発項目3 幹事企業
- ☆ 研究開発内容①-2とりまとめ企業
- ◆ 中小・ベンチャー企業

各主体の役割

- 研究開発項目3は、アイオーコア(株)、富士通(株)、日本電気(株)、キオクシア(株)、富士通オプティカルコンポーネンツ(株)、京セラ(株)による共同実施である
- 研究開発内容①-1光電融合デバイス開発はアイオーコア(株)が担当し、「量子ドットレーザの高温化技術の開発」を東京大学に再委託する
- 研究開発内容①-2光スマートNIC開発は、富士通(株)、富士通オプティカルコンポーネンツ(株)、京セラ(株)の3者が担当する、また一部を産業技術総合研究所が担当する
- ②-1省電力CPU開発は富士通が担当する
- ②-2省電力アクセラレータ開発、③ディスクアグリゲーション技術の開発は日本電気(株)が担当する
- ②-4広帯域SSD開発はキオクシア(株)が担当する

研究開発における連携方法（共同実施者間の連携）

- 共同実施者で開発状況や課題を定期的に共有し、研究計画・目標の見直しなどの連携を行う
- ①-2光スマートNIC開発に特化した連携として、富士通(株)、富士通オプティカルコンポーネンツ(株)、京セラ(株)、および産業技術総合研究所で開発状況や課題を定期的に共有し、研究計画・目標の見直しなどの連携を行う
- これらの連携により、ステージゲート、社会実装に向けて互いに連携し、KPI、及び、アウトプットの目標達成を目指す

共同実施者以外の本プロジェクトにおける他実施者等との連携

- ②-3不揮発メモリ開発は本共同実施に含まれないが、不揮発メモリ開発の実施者とも定期的なミーティングなどで連携を行う
- 次世代グリーンデータセンター用デバイス・システムに関する協議会を設置し、外部機関と連携を行う

中小・ベンチャー企業の参画

- 中小・ベンチャー企業であるアイオーコア(株)が参画

2.1 共同実施による研究開発内容／（５）技術的優位性

国際的な競争の中においても技術等における優位性を保有

研究開発項目	研究開発内容	活用可能な技術等	競合他社に対する優位性・リスク
研究開発項目3 次世代グリーン データセンター 技術開発	① -1 光電融合デバイス開発	25Gbps x 4チャネルの超小型光トランシーバ「光I/Oコア」をアイオーコア(株)が製品化 100℃で動作可能な光モジュールの設計・製造技術をアイオーコア(株)が保有	5x5mm²の「光I/Oコア」は世界最小 100℃で動作可能な光モジュールを製造できる企業はアイオーコアのみ - 競合他社との価格競争がリスク
	① -2 光スマートNIC開発	- 国内・北米を中心に展開している最先端光伝送装置のハードウェア・ソフトウェア開発技術 - 上記に適用するFPGA等の論理回路設計技術、ネットワークOS、ネットワーク運用ソフトウェアの設計技術を有する	- 光スマートNICは従来の光伝送装置、スマートNICに対し、フレキシビリティ・電力・伝送容量/距離等の指標で優位性を有する - 大手チップベンダーが類似製品を開発販売すること、実施者がデータセンター市場に十分なフットプリントがないことがリスク
	② -1 省電力CPU開発	- 省電力プロセッサ開発技術 (Green500 No.1@2019年) - ハイエンドプロセッサ開発技術 (富岳4冠、UNIX/メインフレーム製品出荷)	- 優位性：Intel CPUに対して、3倍の電力性能を達成 - 優位性：富岳性能4期連続 4冠達成 - リスク：開発技術のQCD目標未達
	② -2 省電力アクセラレータ開発	- ベクトル処理・ベクトルキャッシュ技術 - AI処理に適用可能なマトリクス演算技術	- 高性能ベクトル技術・広帯域ベクトルキャッシュ技術は製品の経験より優位 - リスクとしてマトリクス演算技術に関してはフォロワーであり、十分な検討・評価が必要である
	② -4 広帯域SSD開発	- NVMe™ SSD - ストレージ管理ソフトウェア	- 優位性：NANDフラッシュメモリからSSDまで完全内部設計なので、最新技術の導入が容易 - リスク：変化の激しい「データセンタービジネス」への対応に向けて製品仕様策定や開発で競合に遅れをとるリスクあり
	③ ディスアグリゲーション 技術の開発	- 仮想・物理構成変更技術 - PF抽象化・設計自動化技術	- 従来装置の構成変更技術に対する継続的な取り組み - 要件から設計・構成を導出する技術に関する研究成果はNEC優位

NVMe は、NVM Express, Inc. の米国またはその他の国における登録商標または商標です。

2.2 光電融合デバイス開発

2.2 光電融合デバイス開発／（1）研究開発目標

DCの省力化40%以上というアウトプット目標を達成するために必要な複数のKPIを設定

研究開発テーマ

1

ー1

光電融合デバイス開発

アウトプット目標

- ・PCIe6.0 に対応した光トランシーバを開発
- ・チップ間接続の消費電力を電気配線と比較して90%削減

研究開発課題

1

PCIe5.0光モジュール
技術開発

KPI

32G×4laneの光I/Oコアを2個搭載し8laneモジュールを開発し最大動作温度100℃を実証する。

KPI設定の考え方

DC内のインターフェースの規格としてPCIeの導入が始まっている。次世代DC向けに検討が進んでいるPCIe5.0（32Gbps）で先行して高温動作可能な光モジュール技術を開発する。

2

PCIe6.0光モジュール
技術開発

64G_PAM4光I/Oコアを2個搭載し、8lane光モジュールを開発し最大動作温度100℃を実証する。

成果の社会実装が進む2026年にはPCIe6.0（64Gbps）が幅広く普及すると予想されることから、最終課題としてPCIe 6.0の高温動作可能な光モジュール技術を開発する。

3

量子ドットレーザの高
温化技術の開発

130℃超で動作可能な量子ドットレーザを実現する。

CPU等の消費電力がさらに増加し、光モジュール周辺の発熱量が増大する可能性があることから、将来技術としてさらなる高温動作を可能とするレーザ技術を開発する。

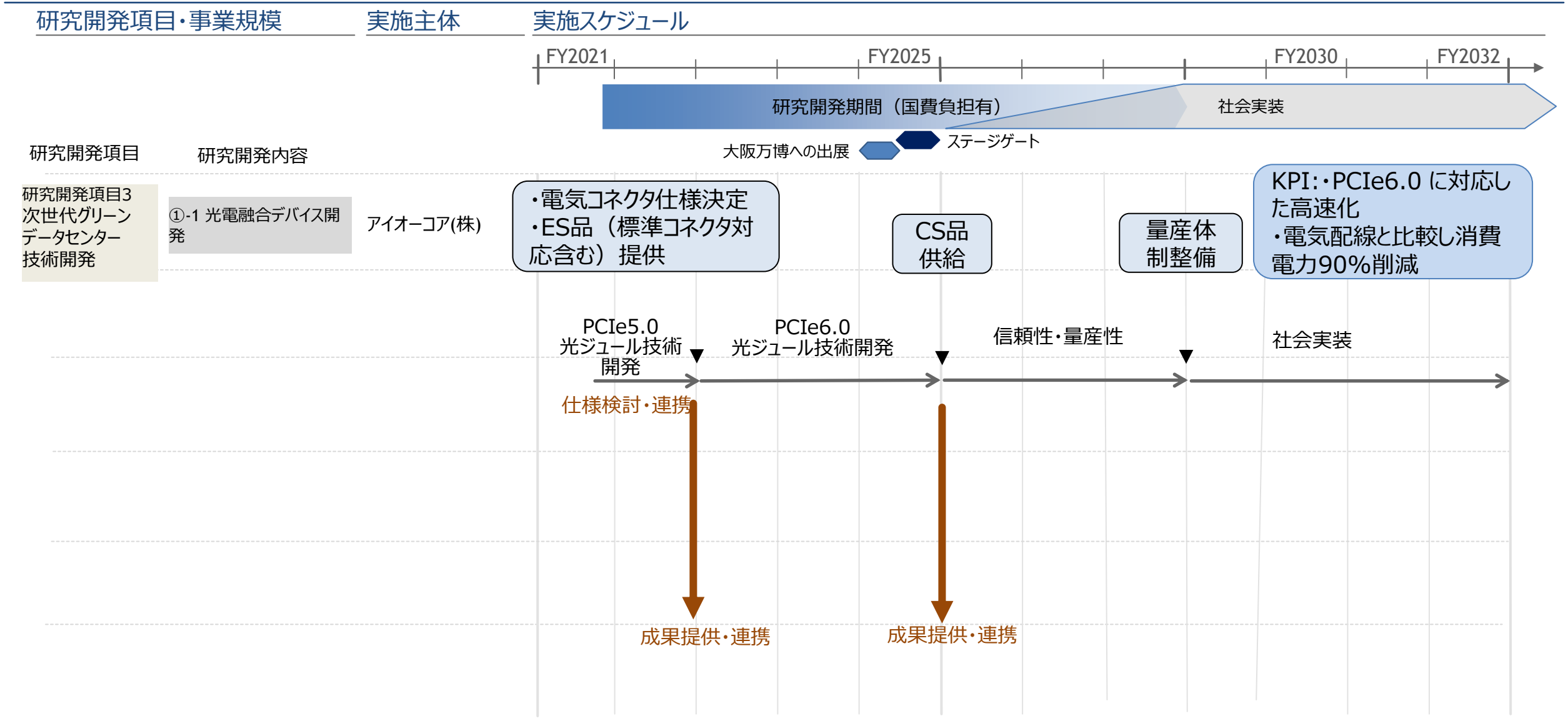
2.2 光電融合デバイス開発／（2）研究開発内容

各KPIの目標達成に必要な解決方法を提案

研究開発内容	KPI	現状	達成レベル (2030年)	解決方法	実現可能性 (成功確率)
① -1 光電融合デバイス 開発	・PCIe6.0 に 対応 ・電気配線と 比較して電力 90%減	電子回路等 の要素技術 (TRL4)	信頼性・量 産性を満足 した製品レ ベル(TRL9)	● 低損失シリコンフォトニクス回路技術 ① リニアリティの高い光素子による高速 PCIe6.0（32GBau,PAM4） ② 電子回路のCDRが不要となり低電力化	低損失シリコン フォトニクス回路 の適用により高い 実現可能性 (90%)

2.2 光電融合デバイス開発／（3）実施スケジュール

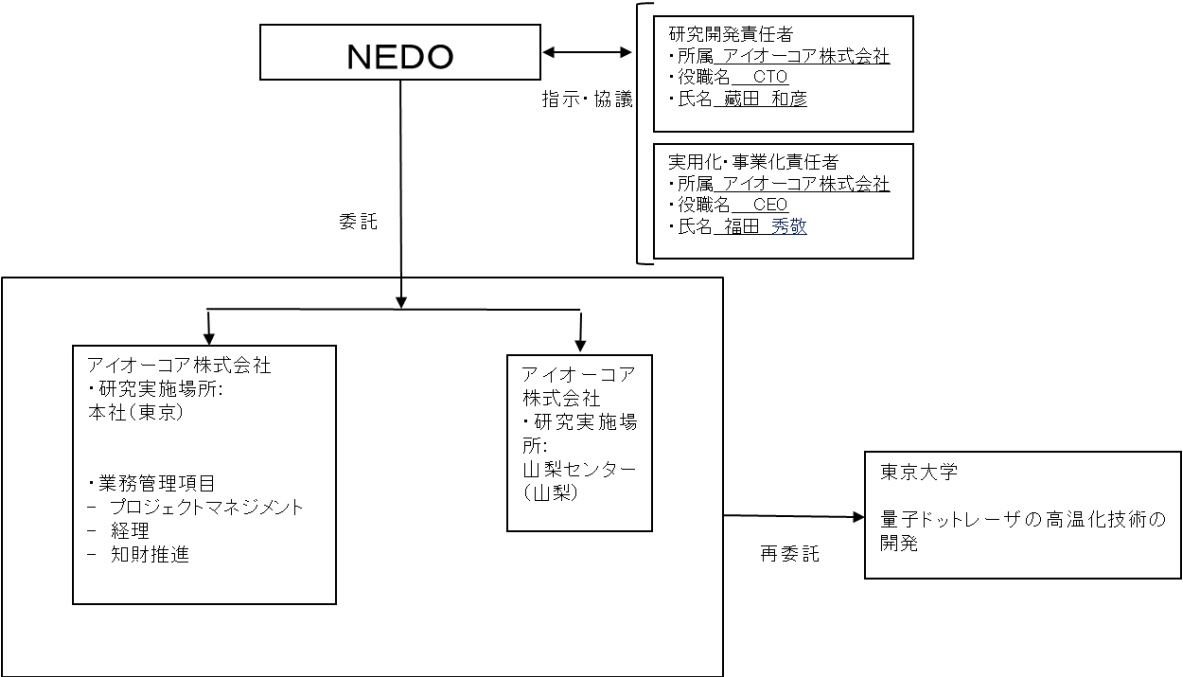
複数の研究開発を効率的に連携させるためのスケジュールを計画



2.2 光電融合デバイス開発／（４）研究開発体制

各主体の特長を生かせる研究開発実施体制と役割分担を構築

実施体制図



各主体の役割

- 研究開発内容①-1光電融合デバイス開発はアイオーコア(株)が担当し、「量子ドットレーザの高温化技術の開発」を東京大学に再委託する

研究開発における連携方法（共同実施者間の連携）

- 共同実施者で開発状況や課題を定期的に共有し、研究計画・目標の見直しなどの連携を行う
- これらの連携により、ステージゲート、社会実装に向けて互いに連携し、KPI、及び、アウトプットの目標達成を目指す

共同実施者以外の本プロジェクトにおける他実施者等との連携

- ②-3不揮発メモリ開発は本共同実施に含まれないが、不揮発メモリ開発の実施者とも定期的ミーティングなどで連携を行う
- 次世代グリーンデータセンター用デバイス・システムに関する協議会を設置し、外部機関と連携を行う

中小・ベンチャー企業の参画

- 中小・ベンチャー企業であるアイオーコア(株)が参画

2.2 光電融合デバイス開発／（５）技術的優位性

国際的な競争の中においても技術等における優位性を保有

研究開発項目	研究開発内容	活用可能な技術等	競合他社に対する優位性・リスク
研究開発項目3 次世代グリーン データセンター 技術開発	① -1 光電融合デバイス 開発	25Gbps x 4チャネルの超小型光トランシーバ「光I/Oコア」をアイオーコア(株)が製品化 100℃で動作可能な光モジュールの設計・製造技術をアイオーコア(株)が保有	5x5mm²の「光I/Oコア」は世界最小 100℃で動作可能な光モジュールを製造できる企業はアイオーコアのみ - 競合他社との価格競争がリスク

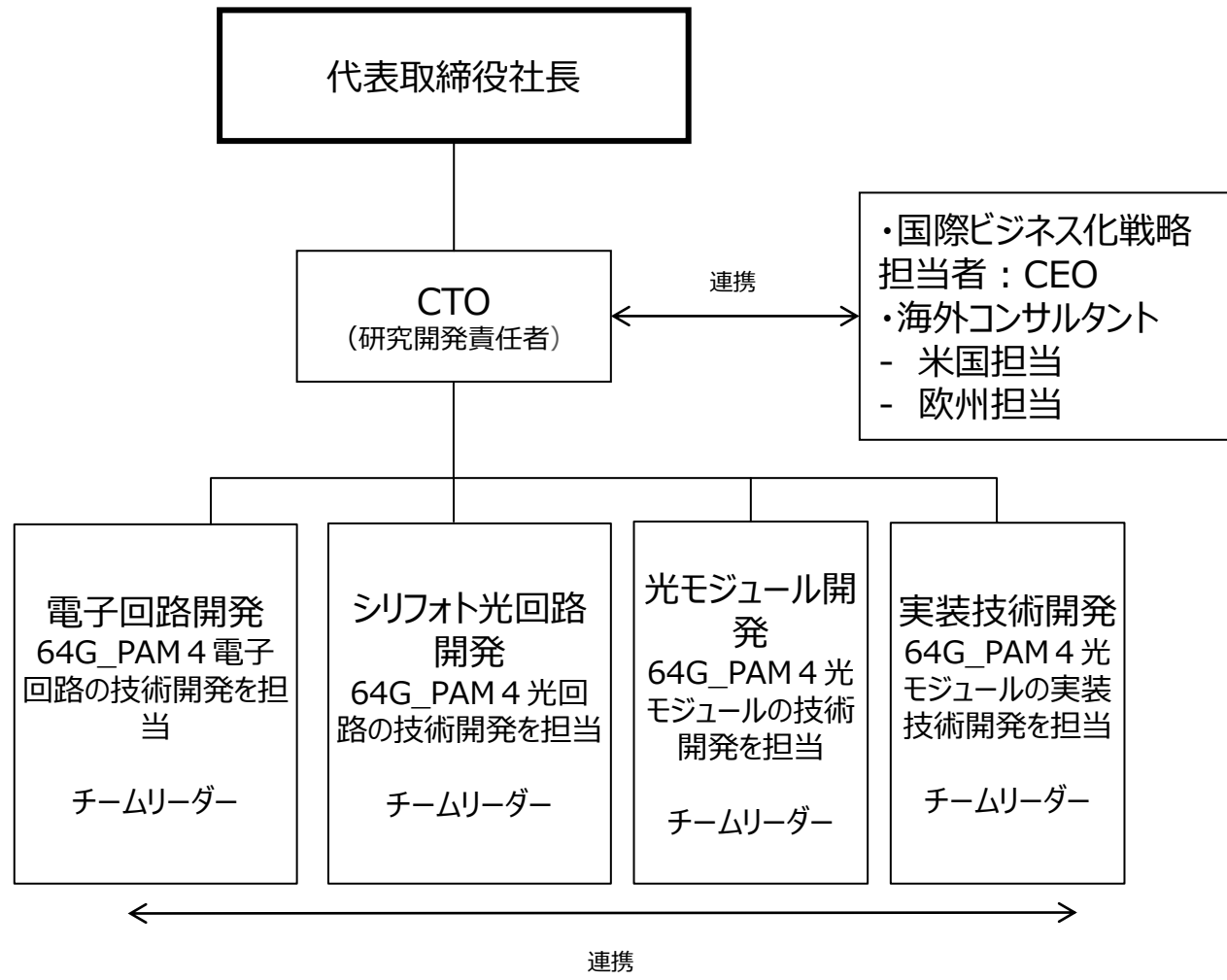
3. イノベーション推進体制

(経営のコミットメントを示すマネジメントシート)

3. イノベーション推進体制／（1）組織内の事業推進体制

経営者のコミットメントの下、専門部署に複数チームを設置

組織内体制図



組織内の役割分担

研究開発責任者と担当部署

- 研究開発責任者
 - CTO：研究開発全体を統括
- 国際ビジネス化戦略担当者：CEO
 - 海外コンサルタント
 - 米国担当
 - 欧州担当
- 担当チーム
 - 電子回路開発：64G_PAM 4 電子回路の技術開発を担当（専任2人、併任2人規模）
 - シリフト光回路開発2：64G_PAM 4 光回路の技術開発を担当（専任3人、併任3人規模）
 - 光モジュール開発：64G_PAM 4 光モジュールの技術開発を担当（専任1人、併任1人規模）
 - 実装技術開発：64G_PAM 4 光モジュールの実装技術開発を担当（専任1人、併任3人規模）

部門間の連携方法

- コンパクトなベンチャー企業であり、全体会議、テーマごとの打ち合わせを適宜開催し、連携を図る

3. イノベーション推進体制／（2）マネジメントチェック項目① 経営者等の事業への関与

経営者層が自ら現場の現状と課題を把握し、スピーディかつタイムリーな経営判断を遂行

経営ビジョン

- 良い技術を提供することにより、社会の皆の厚生を高めること

経営戦略

- コンピュータ領域における超小型低消費電力の光トランシーバを中核とした事業経営

経営者のリーダーシップ

- CEOが、社内外の幅広いステークホルダーに対して、行政や関連企業との対話や右記会議などを通じて当該事業の重要性をメッセージとして発信
- カーボンニュートラルに関わる産業構造変革の仮説や自社の事業構造との関わりを社内外に示し、その中に当該事業を位置づけ

事業のモニタリング

- 右記会議体を主導し、経営、技術、製造、販売の各観点で、現状を把握し、課題を抽出。
- 関連メンバとの議論を通じて、タイムリーな対応策を推進

会議体系

- 取締役会
 - 月1回
 - 参加者；常勤取締役、外部取締役、監査役、オブザーバとして企業株主殿
 - 経営の現状と課題及び将来計画につきステークホルダの理解を得ることを目的とする
- 経営会議
 - 隔週
 - 参加者；経営層及び関連部長
 - 経営の進捗と課題を共有し、進むべき方向性を議論
- 技術会議
 - 週1回
 - 参加者；全員
 - 技術の進捗と課題を全員で共有
- 製造・販売会議
 - 隔週
 - 参加者；経営層及び関連部長
 - 製造及び営業の現状と課題を関係者で共有
- 上記の会議を役員が主導し、けん引することで、スピーディかつタイムリーな経営判断を行うことが出来る

3. イノベーション推進体制／（3）マネジメントチェック項目② 経営戦略における事業の位置づけ

経営戦略の中核としてコンピュータ領域の光トランシーバ事業を位置づけ新会社スタート

アイオーコア社設立の経緯

- PETRAにて超小型・低消費電力光トランシーバの開発開始（2012年）
- 25Gbps・5mW・5mm□の超小型光トランシーバ（光I/Oコア）の開発に成功
- 2017年PETRAからカーブアウトし、アイオーコア社設立

アイオーコア社の事業戦略

【事業領域】

- HPC、AI、5G、IOT、自動運転などコンピュータ能力の向上へ期待増大
- コンピューティング能力の向上には並列処理・分散処理が必須
- 並列処理・分散処理には半導体間的高速通信がボトルネック、銅配線から光配線への転換が見え始める
- 光配線に求められる性能は、超小型、低消費電力、低レイテンシ、高温動作、高信頼、かつ安価
- 光I/Oコアの性能はそれらの要求にミートする
- グローバルな大企業からのサンプル提供のオファー多

【事業形態】

- ファブレスの製造販売会社
- 生産委託会社と連携して生産技術開発
- 製造装置の一部はアイオーコア社内製でパートナー企業に貸与（安易な模倣は困難）
- 光トランシーバは、パートナー企業と連携し開発・販売

製品ラインアップ

- 25Gbps NRZ 光I/Oコア
- 32Gbps NRZ 光I/Oコア（更なる信頼性向上に着手）
- 50Gbps NRZ 光I/Oコア（開発中）
- 64Gbps PAM4 光I/Oコア（開発中）

想定顧客

- 国内外のユーザ

取締役会

- 参加者は常勤取締役、外部取締役、監査役、オブザーバとして主要株主殿
- 事業戦略・事業計画の決議・変更
 - 取締役会にて事業戦略・事業計画の議論を行い、了解を得る
 - 事業の進捗状況について定期的にフォローし、事業環境の変化等に応じて見直しを行う

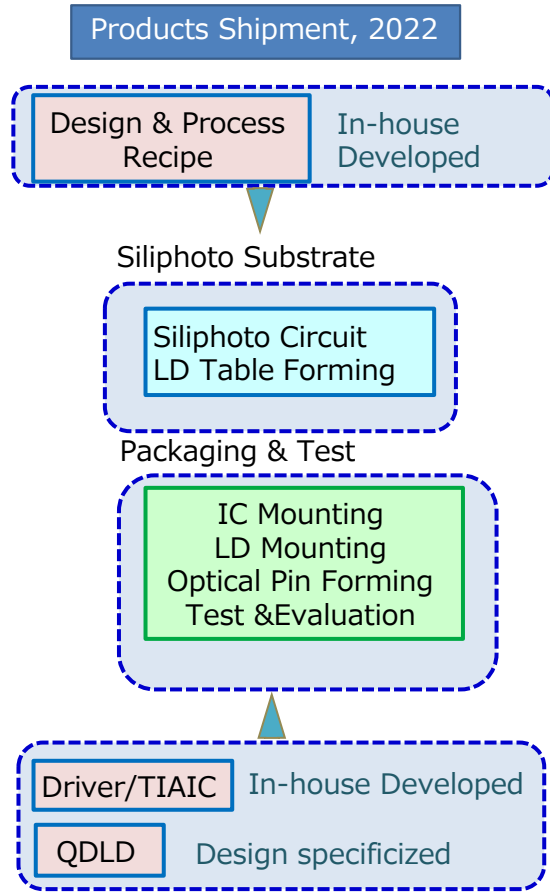
3. イノベーション推進体制／（4）マネジメントチェック項目③ 事業推進体制の確保

サプライチェーンを構成する企業と連携し開発を進め、着実に社会実装を実現

開発担当役員の下、研究開発と生産技術を一括管理

- 生産技術の確立
 - 光I/Oコアの基本構成、基本作製技術は開発済
 - アイオーコア社はフェブレス企業
 - サプライチェーンを構成する関連企業と連携し、生産技術を確立
- サプライチェーンの確保
 - IC（自社開発）、QDレーザー（評価し仕様を決定）などを調達し、モジュール化
 - シリフォト製作、回路設計・製作、部品実装、の各工程を担当する企業と連携して技術開発
- 顧客ニーズへの早期対応
 - グローバルな顧客からサンプル提供の依頼
 - 顧客ニーズに応じて早期にサンプル提供しフィードバックを得て、品質改善
- 人材確保
 - 市場の広がりに対応し、適宜技術人材と営業人材を確保
- 設備投資
 - 市場の拡大に応じて、生産ラインを拡充に向け3億円／ラインの設備投資を必要年度に計画

アイオーコア社のサプライチェーンの一例



4. その他

4. その他／（１）想定されるリスク要因と対処方針

リスクに対して十分な対策を講じるが、判断基準に合致した場合は事業中止も検討

研究開発（技術）におけるリスクと対応

- 64Gbps PAM4電子回路とシリコンフォトニクス回路の試作を伴う研究開発が世界的なLSI需給の逼迫により遅延するリスク
- ⇒ 回路特性のシミュレーションの精度を高め、マスク設計の品質を向上させる等を実施し、試作が十分な回数できなかった場合に備える
- ⇒ 当該開発を通じてシリフォトファブとの連携を強化

社会実装（経済社会）におけるリスクと対応

- Amazon等のハイパースケールデータセンターが、サーバーのインターフェースとして国際標準であるPCIeではなく、独自の仕様を設定することによるリスク
- ⇒ 米国の開発動向を早期に入手するために、アイオーコア(株)は、米国大手データセンター並びに半導体メーカーとサーバーのインターフェースの開発仕様に関して協議を開始している。

その他（自然災害等）のリスクと対応

- 地震等の自然災害により生産拠点が被害を受けるリスク
- ⇒ 複数の量産ラインを構築することで、被災した装置を部品レベルで交換し、最低 1 ラインを動かす。
- ⇒ 新潟の量産ラインとは別に、山梨に試作センターを有しており、基本装置は代替可能になっているので、山梨から新潟に部品/装置を運び込んで、ラインを動かす。等を実施



- 事業中止の判断基準：
 - ① 研究開発（技術）におけるリスク： LSI需給の逼迫が継続し、開発期間中に回路試作が行えなかった場合
 - ② 社会実装（経済社会）におけるリスク： Amazon等のハイパースケールデータセンターの独自仕様に、本事業の開発技術の仕様がマッチしなかった場合